

平安证券股份有限公司
关于甬矽电子（宁波）股份有限公司
使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司
提供借款以实施募投项目的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对甬矽电子使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目相关事项进行了审慎尽职调查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，公司向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币116,500.00万元，扣除不含税的发行费用13,701,179.22元，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。上述募集资金已于2025年7月2日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验【2025】177号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额（调整前）	拟投入募集资金金额（调整后）注
1	多维异构先进封装技术研发及产业化项目	146,399.28	90,000.00	90,000.00
2	补充流动资金及偿还银行借款	26,500.00	26,500.00	25,129.88
合计		172,899.28	116,500.00	115,129.88

注：关于本次拟投入募集资金金额（调整后）的相关内容详见公司于2025年7月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-056）。

三、本次使用募集资金向控股子公司提供借款的情况

根据《募集说明书》，公司募集资金投资项目中“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”的实施主体为公司控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称甬矽半导体），拟投入募集资金总额为 90,000.00 万元。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 90,000.00 万元向甬矽半导体提供借款，公司将根据募投项目的建设进展及实际资金需求，在借款总额度内分批次划转至甬矽半导体开立的募集资金专户。借款利率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日同期贷款市场报价利率（LPR）确定，甬矽半导体其他股东将不提供同比例借款。借款期限为自实际借款之日起不超过 3 年，到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。未来实际借款时，公司将与甬矽半导体签订具体的借款协议，公司董事会授权公司总经理全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、本次提供借款对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称	甬矽半导体（宁波）有限公司
统一社会信用代码	91330281MA2KN17R2J

成立日期	2021-07-07
法定代表人	王顺波
注册资本	400,000万(元)
住所	浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号（自主申报）
股权结构	甬矽电子（宁波）股份有限公司持股60%，宁波复华甬矽集成电路产业股权投资中心（有限合伙）持股20%，宁波市甬欣基金合伙企业（有限合伙）持股20%。
经营范围	一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件零售；包装材料及制品销售；国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	8,698,649,231.02
负债总额	4,882,757,576.84
净资产	3,815,891,654.18
项目	2024年度（经审计）
营业收入	907,078,319.85
净利润	-68,097,021.04

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向控股子公司甬矽半导体提供借款，是为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，且符合公司整体战略规划和长远利益，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

六、本次借款后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款将存放于募集资金专户进行管理，并将严格按照公司、控股子公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金四方监管协议》的约定进行有效监管。公司及甬矽半导体将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的要求规范使用募集资金，对募集

资金使用实施有效监管，同时严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序及专项意见

（一）公司履行的审议程序

公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十七会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司甬矽半导体提供借款 90,000.00 万元以实施向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）相关专项意见

公司监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项的审议程序符合相关法律、法规及监管规定，是基于募投项目建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关要求。公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。综上，保荐机构对公司本次使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于甬矽电子（宁波）股份有限公司使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周超

周超

夏亦男

夏亦男

